# (19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-16440

(43)公開日 平成6年(1994)1月25日

技術表示	FI	庁内整理番号	識別記号	(51)Int.Cl. <sup>5</sup>
		9041 — 4 G		C 0 3 B 29/00
		9151 —4 G	В	В 0 1 Ј 19/12
		7425-4E	320 E	B 2 3 K 26/00

# 審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

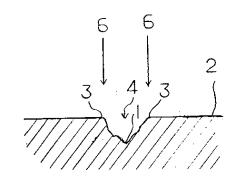
(21)出願番号	特顯平4-173339	(71)出願人	000005049	
			シャープ株式会社	
(22)出顧日	平成 4年(1992) 6月30日		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	
		(72)発明者	宮▲崎▼ 修	
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	シ
			ャープ株式会社内	
		(72)発明者	吉村 和也	
		. ,,=	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	シ
			ャープ株式会社内	
		(72)発明者	中并一俊治	
		(107)07376	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	シ
			ャープ株式会社内	
		(7A)41>391 A	弁理士 山本 秀策	
		(14)八里八	开连工 四平 乃泉	
		1		

# (54)【発明の名称】 透明板表面の欠陥修正方法

# (57)【要約】

【目的】 研磨粉を使用した研磨によることなく、短時 間で透明板表面の欠陥を透光性を損なうことなく修正す る方法を提供する。

【構成】 透明板表面2に形成された凹状欠陥部分4に ArFエキシマレーザビーム6を照射して、該欠陥部分 4を平滑化する。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】透明板表面に形成された凹状欠陥部分にA rFエキシマレーザビームを照射して、該欠陥部分を平 滑化する透明板表面の欠陥修正方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ガラス等の透明材料か らなる板表面を、透光性を損なうことなく欠陥修正する 方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】液晶表示装置等に使用されるガラス板等 の透明板表面に生じた傷等の欠陥は、例えば、研磨粉を 含んだ研磨液をつけたグラインダー等を回転させつつ透 明板表面に接触させて機械的に研磨することにより修正 される。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このような機 械的な研磨による欠陥修正方法では、非常に時間がかか るだけでなく、ガラスが削られて生じたガラス粉末や研 磨粉が飛び散り、表示装置内にこれら飛散物が入って不 20 め、透光性が損なわれてしまう。 良の原因となったり、また作業環境が悪くなるという問 題がある。さらに、透明板にLSIが実装されている場 合には、透明板表面とグラインダーとの摩擦の際に生じ る振動、あるいは静電気等により、実装されたLSIが 破壊される恐れがある。

【0004】本発明は、上記欠点を解決しようとするも のであり、研磨粉を使用した研磨によることなく、短時 間で透明板表面の欠陥を透光性を損なうことなく修正す る方法を提供することを目的とする。

### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明の研磨方法は、透 明板表面に形成された凹状欠陥部分にArFエキシマレ ーザビームを照射して、該欠陥部分を平滑化し、そのこ とにより上記目的が達成される。

## [0006]

【作用】ArFエキシマレーザは、紫外領域の光を発生 することができ、この紫外光が照射されることにより透 明板を形成する材料の原子間結合が断ち切られ、照射さ れた部分が削られてほぼ平らな面となり、透明板表面の 欠陥が透光性を損なうことなく修正される。

### [0007]

【実施例】以下、本発明を図面を参照して説明する。

【0008】本発明の方法は、図1に示すように、ガラ ス板表面2に、傷4が形成されている場合に、この傷4 上からArFエキシマレーザビーム6を照射する。

【0009】傷4にArFエキシマレーザビーム6を照 射すると、傷4は、その全体が削られて深くなるのでは なく、その上部3から徐々に削られていき、ついには図 2に示すように傷4の底部1とガラス板表面2とがなだ らかに連続する平滑な面となる。時間は数十秒程度で非 50 常に短時間であり、かつ加工面の透光性が損われること なくガラス板表面2を研磨することができる。

【0010】エキシマレーザは、紫外領域のレーザビー ムを発生することが可能であり、そのレーザビームによ って被加工物の原子の間の結合を断ち切ることにより熱 発生を伴わずに被加工物の表面を加工することができ る。ガラスなどの透明材料を加工する場合には、レーザ ビームの波長によってはガラスを透過して原子間結合を 断ち切れないため、レーザビームがその材料表面で吸収 される波長を選択する必要がある。エキシマレーザの波 長は使用するガスの種類により発振波長が異なるが、図 3に示すように、ArFエキシマレーザを用いて平坦な ガラス板表面22を切削加工すると、削られた加工部の 底面21はほぼ平らになり、透光性は損なわれない。 【0011】透明材料に吸収される波長のレーザビーム

を発生するエキシマレーザとしてはKrFエキシマレー ザがあるが、KrFエキシマレーザを用いて平坦なガラ ス板表面32を切削加工すると、図4に示すように、削 られた加工部の底面31は激しい凹凸が形成されるた

【0012】なお、ArFエキシマレーザビームを照射 してガラス板表面の欠陥を修正する際には、欠陥を含む 広い領域にArFエキシマレーザビーム6をあてること により、図3に示すようなエッジ23が形成されること が防止されて、ガラス板の欠陥が良好に修正される。

【0013】欠陥修正時には、ガラスが削られると微量 の飛散物が生じるが、研磨粉を用いて研磨する場合に比 較すると大幅に減少する。飛散物が加工部に付着するこ とを防ぐには、レーザビーム照射部以外をマスキングす 30 ればよい。

#### [0014]

【発明の効果】本発明では、ArFエキシマレーザを用 い、加工面をなめらかな面とすることができるので、透 明板の透光性を損なうことなく欠陥修正することができ

【0015】レーザビーム照射によって研削されるの で、加工面に摩擦が生じることがない。よって、震動、 静電気等が生じないため、透明板にLSIが実装されて いる場合でも、LSIが破壊される恐れがない。

【0016】さらに、研磨時に若干の飛散物が生じるも のの研磨粉を用いた従来の方法と比べて大幅に減少する ので、クリーンな状態で作業を行うことができる。

【0017】また、数十秒程度の短時間で欠陥修正する ことができるので、作業の簡略化、時間短縮を図ること ができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】ガラス板表面にArFエキシマレーザを照射す る様子を示す模式図。

【図2】 欠陥修正後のガラス板の断面図。

【図3】ArFエキシマレーザを用いて削ったガラス板

3

の断面図。

【図4】KrFエキシマレーザを用いて削ったガラス板 の断面図。

【符号の説明】

2 ガラス板表面

4 傷

6 ArFエキシマレーザビーム

4

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】